



ServMAX[®] TL73-H3

突出特性

- 单路AMD EPYCT[™] 7003/7002系列处理器
- 封闭式液冷设计
- 支持7片液冷GPU
- 整机运行噪音低于53dB
- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘
- 丰富的I/O扩展

应用场景

工程分析、图像识别、编解码技术

软件开发、智慧金融

自动驾驶

视频监控

大数据

移动通信等



全液冷散热，极致降噪

满负荷整机噪声低于53dB；循环风道设计，散热无死角；风扇转速可调，寻求效率和静音的平衡；封闭循环水路，无漏液风险；漏液报警机制，杜绝隐患



大容量存储

8块3.5/2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求



智能液晶面板，实时监测状态

直观掌握关键温度，实时监测冷却系统若干重要参数

处理器	- 单路AMD EPYC™ 7003/7002系列处理器 - cTDP up to 280W
内存	- 8 x DDR4 DIMM - Up to 1TB 3200MHz-DDR4 RDIMM
GPU	- 支持7片液冷GPU
扩展槽	- 7 x PCIe4.0 x16 slots
网络	- 2 x 10GbE RJ45
I/O	- 1 x VGA - 1 x COM - 5 x USB3.0 - 1 x IPMI RJ45
存储	- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS (含2*NVMe U.2) 热插拔硬盘 - 1 x SATA/NVMe M.2 (2260/2280)
尺寸	- 666.3mm x 380mm x 585mm (H x W x D, 含滚轮)
机箱	- 塔式
电源	- 双80PLUS全模组电源
保修	- 可选现场保修服务

